



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

臻鼎科技控股 (4958 TT)

投資人簡報

2024年8月

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



全球第1大

印刷電路板製造公司

2006年 成立
(前身華虹電子 1978)

台灣桃園 總部

46,693
2023年底員工數



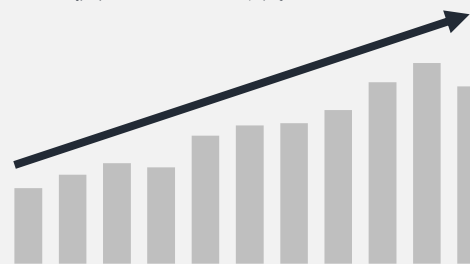
26 座工廠
位於大陸、台灣、印度

NT\$1,514億

2023年營收 (-11.6% YoY)

+9%

2013-2023年
營收年複合成長率



1,648

累計有效獲證專利件數

3,528

累計專利申請
(截至2023年12月底)



NT\$1219.7億

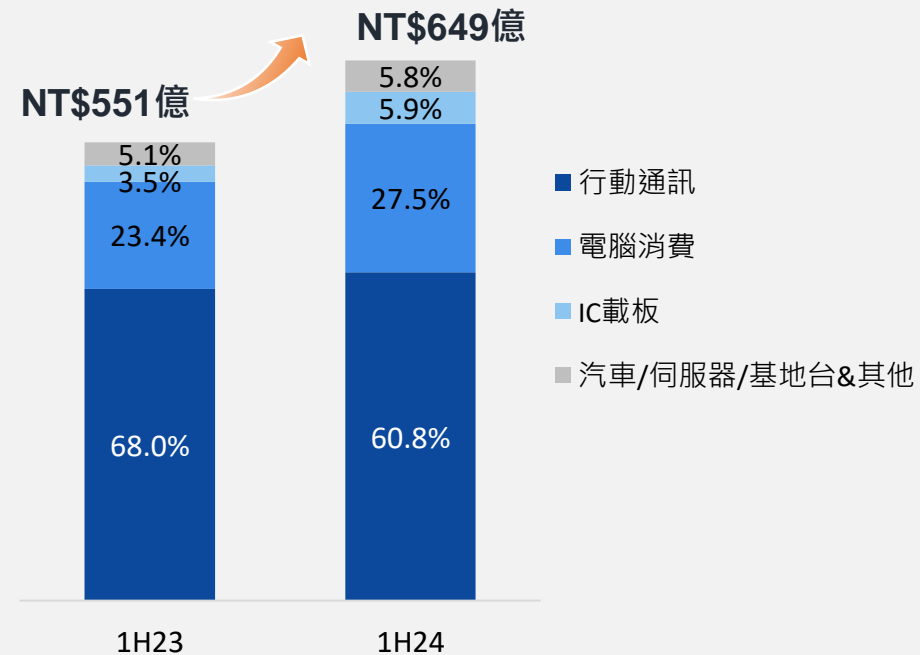
2024年8月14日市值

14.7%

10年平均股東權益報酬率

銷售分析 – 產品應用別

+17.9% YoY



為何投資臻鼎？

1

全球第一大PCB廠，長期穩健成長：

臻鼎自2017年起，榮登全球第一大PCB廠，2013-2023年營收年複合成長率達9%。

2

發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距：

以One ZDT為核心策略，發揮一站購足綜效，持續追求穩健成長。臻鼎2023年全球PCB市佔率為7.0%，目標2030年提升至10%。

3

積極拓展IC載板業務：

臻鼎規劃於2022-2027年投資新台幣600億元資本支出於IC載板，目標2030年成為全球前五大IC載板供應商。

4

全球化生產基地：

除大陸三座主要生產基地，臻鼎在台灣、印度亦設有廠區，目前正於泰國建置新廠，未來將持續拓展全球化生產基地，服務多元客戶需求。

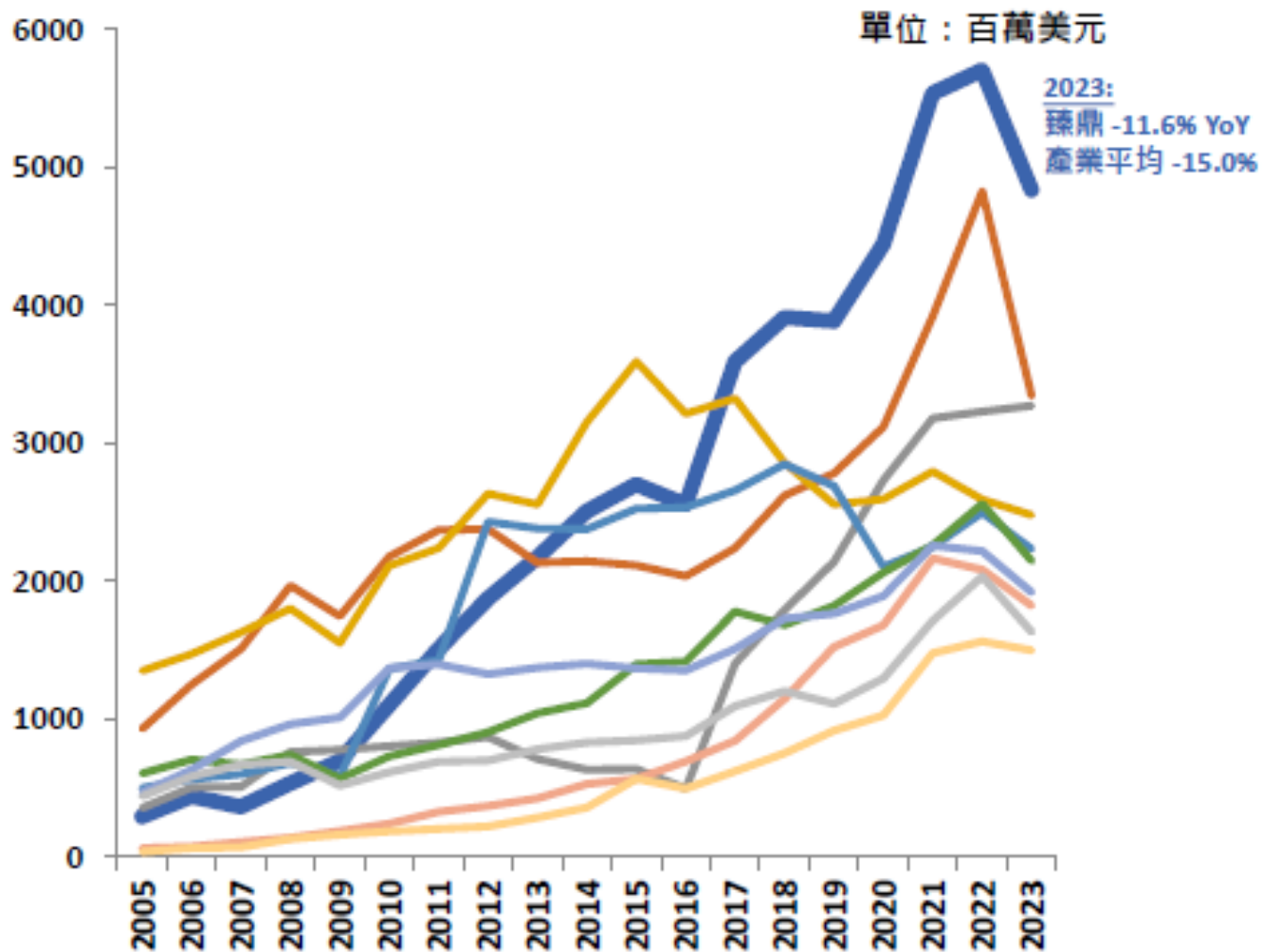


臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

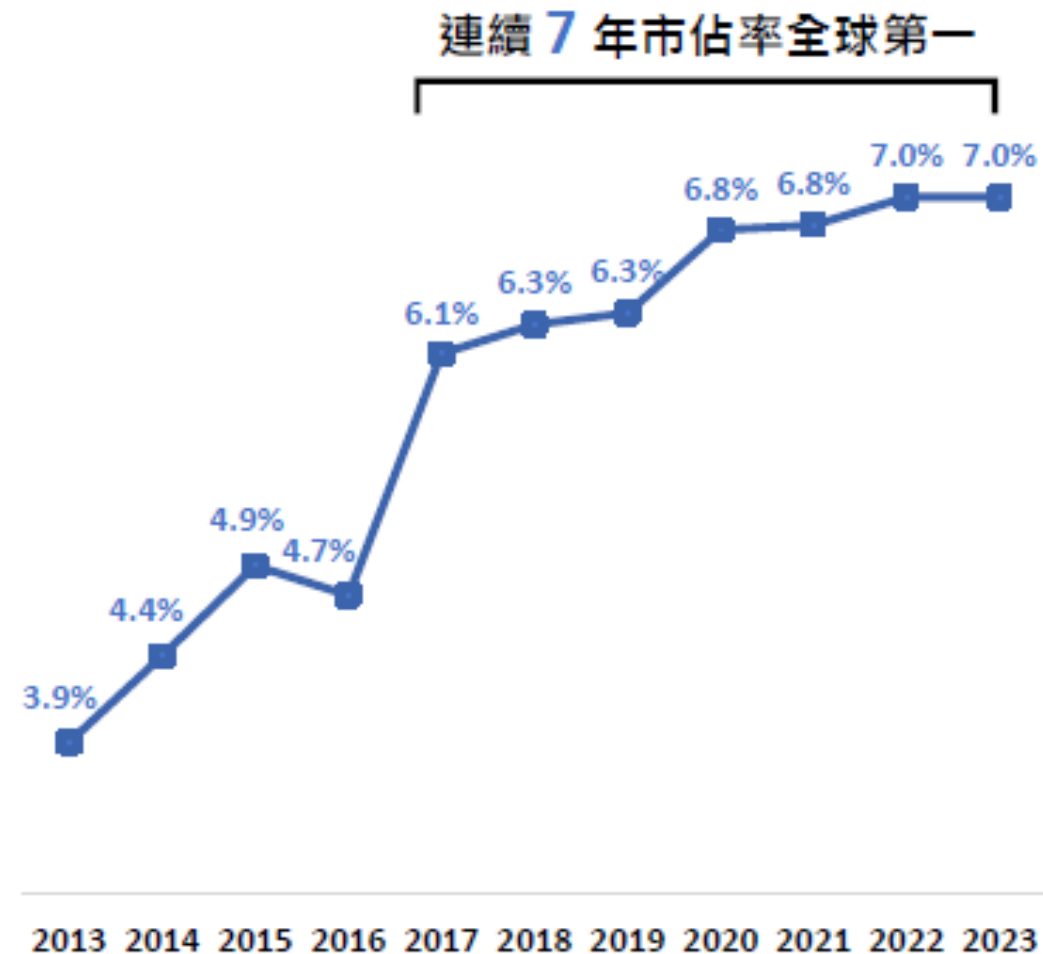
全球第一大PCB廠，長期穩健成長

2023全球前十大PCB領導廠商營收趨勢



資料來源：NT Information；Prismark (2024/02)

臻鼎持續保持PCB產業領先市佔率



資料來源：Prismark

1

第二季營收年增37.7%，優於原先預期，四大產品應用皆達雙位數年增：

臻鼎原先預期第二季營收在客戶產品新舊轉換期影響之下將較第一季回落，但實際營收與前季約略相當，優於原先預期。第二季合併營收達歷年同期次高，四大產品應用同步達雙位數年增，其中IC載板及車載/伺服器/基地台雙雙創下單季歷史新高。

2

下半年進入傳統旺季，客戶新品拉貨動能攀升，同時IC載板、伺服器、車載亦將成長：

受惠客戶新品備貨需求及IC載板、伺服器、車載訂單貢獻，臻鼎預期下半年表現將如過往傳統旺季格局，產能利用率將維持高檔，營收年增幅度可望優於先前預期。

3

隨著各類AI終端裝置(AI手機、AI PC、智能車、AIoT等)推出，預期將帶動各式PCB規格升級與用量提升：

隨著各類終端裝置導入更多AI應用，產品設計將更趨複雜，PCB方面亦須做出相對應的調整，可望帶動臻鼎各式PCB產品規格升級與用量提升。

4

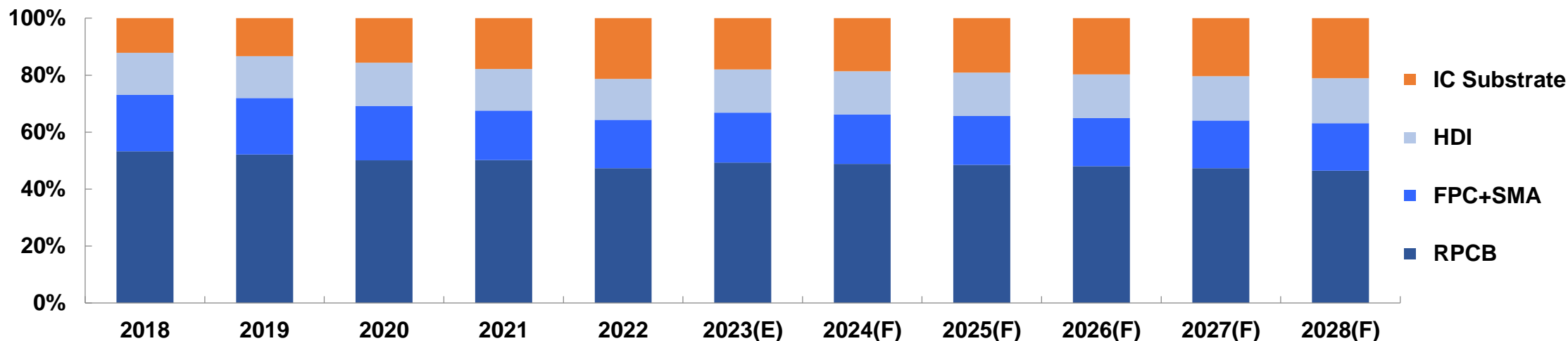
光通訊業務有新訂單斬獲；泰國新廠第一期維持1H25試產、2H25小量產：

光通訊業務成功取得一線客戶訂單，將於第三季開始貢獻營收。泰國新廠第一期產能將以高階伺服器/車載/光通訊相關應用為主，待新廠進入量產，可支應相關產品日益上升的客戶需求。

發揮One ZDT綜效，持續拉開領先差距

目標2030年全球PCB市佔率達10%

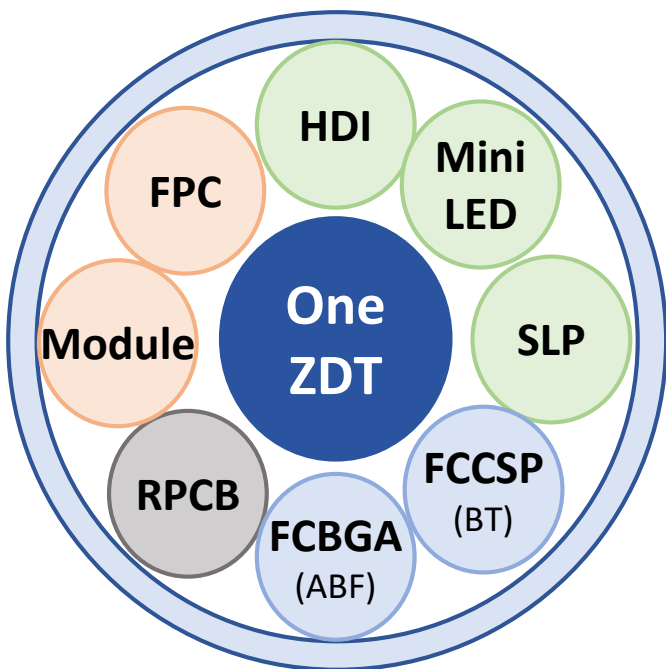
各類PCB市場規模將於2024年重回成長軌道



產品	項目	2018	2019	2020	2021	2022	2023(E)	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2023-2028 CAGR
RPCB	產值	33,225	31,969	32,674	40,641	38,720	34,292	35,451	37,430	39,116	40,429	41,405	3.8%
	佔全球比	53.2%	52.1%	50.1%	50.2%	47.4%	49.3%	48.5%	48.3%	47.7%	46.9%	45.8%	
FPC+SMA	產值	12,395	12,195	12,483	14,058	13,842	12,191	12,779	13,327	13,899	14,495	15,117	4.4%
	佔全球比	19.9%	19.9%	19.1%	17.4%	16.9%	17.5%	17.5%	17.2%	17.0%	16.8%	16.7%	
HDI	產值	9,222	9,008	9,874	11,811	11,763	10,536	11,628	12,356	13,130	13,952	14,826	7.1%
	佔全球比	14.8%	14.7%	15.1%	14.6%	14.4%	15.2%	15.9%	15.9%	16.0%	16.2%	16.4%	
IC Substrate	產值	7,554	8,139	10,188	14,410	17,415	12,498	13,168	14,444	15,844	17,380	19,065	8.8%
	佔全球比	12.1%	13.3%	15.6%	17.8%	21.3%	18.0%	18.0%	19.1%	19.3%	20.1%	21.1%	
合計		62,396	61,311	65,219	80,920	81,740	69,517	73,026	77,558	81,989	86,257	90,413	5.4%
年增率		6.0%	-1.7%	6.4%	24.1%	1.0%	-15.0%	5.0%	6.2%	5.7%	5.2%	4.8%	

資料來源：Prismark(2024/5)；2025~28年係用Prismark數據推估。

從AI終端裝置至AI伺服器 – AI應用朝多元化發展，將使PCB板設計趨於複雜
臻鼎提供業界最完整與先進的PCB產品，打入AI相關的全方位應用



AI

雲



AI 伺服器



邊緣運算
伺服器



高速運算
記憶體

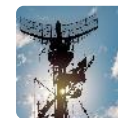
管



光通訊



交換器



基地台

端



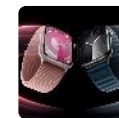
AI 手機/晶片



AI PC



AI 平板



智能穿戴



AR/VR
元宇宙



智能車用
智慧座艙
域控制器

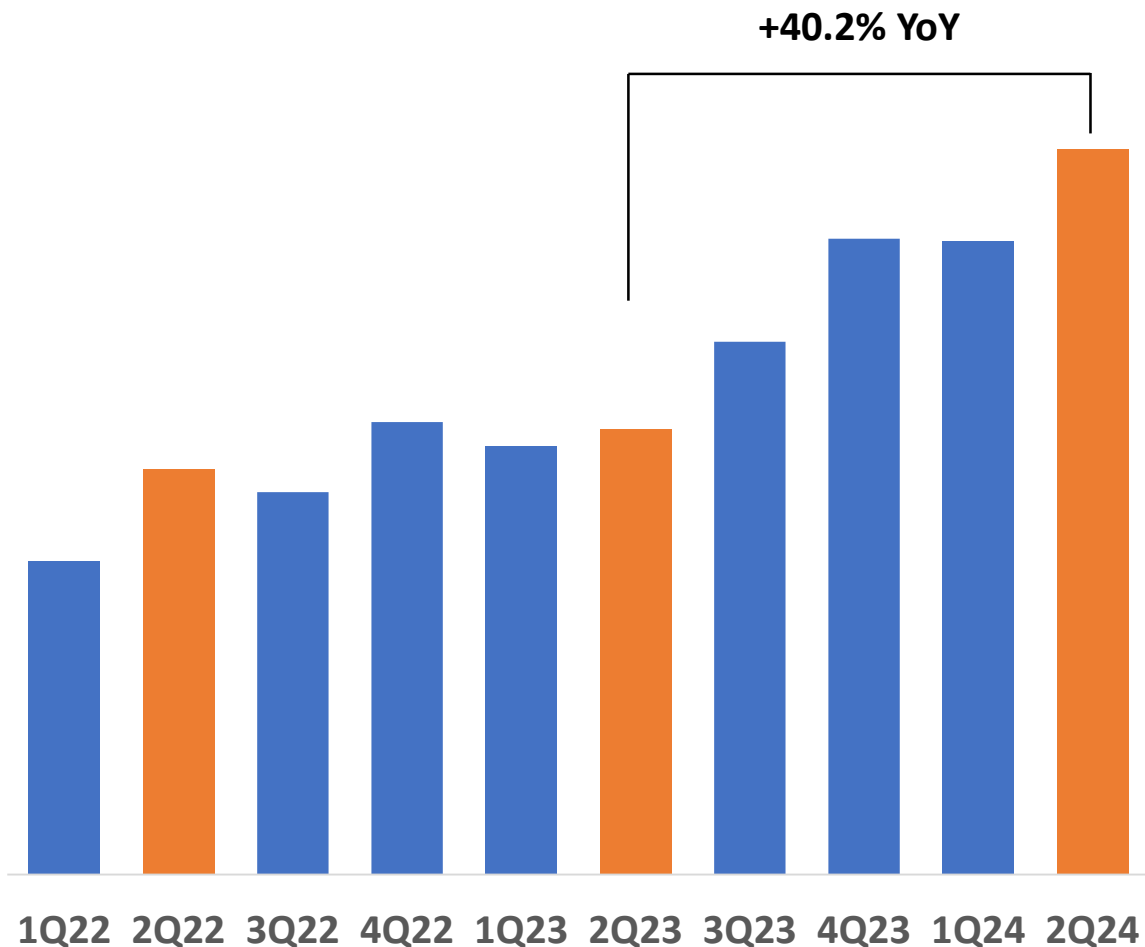


自動駕駛
車用晶片
毫米波雷達

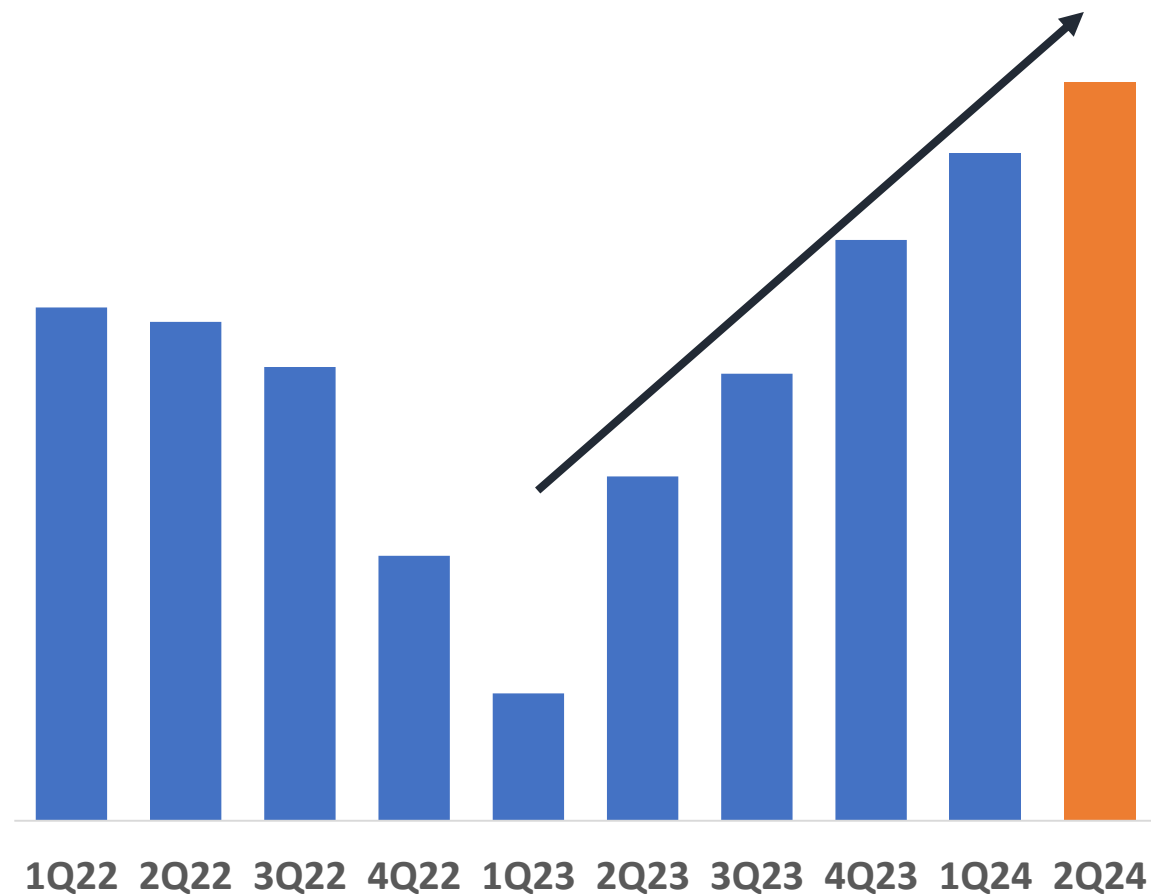


新能源車
電池板

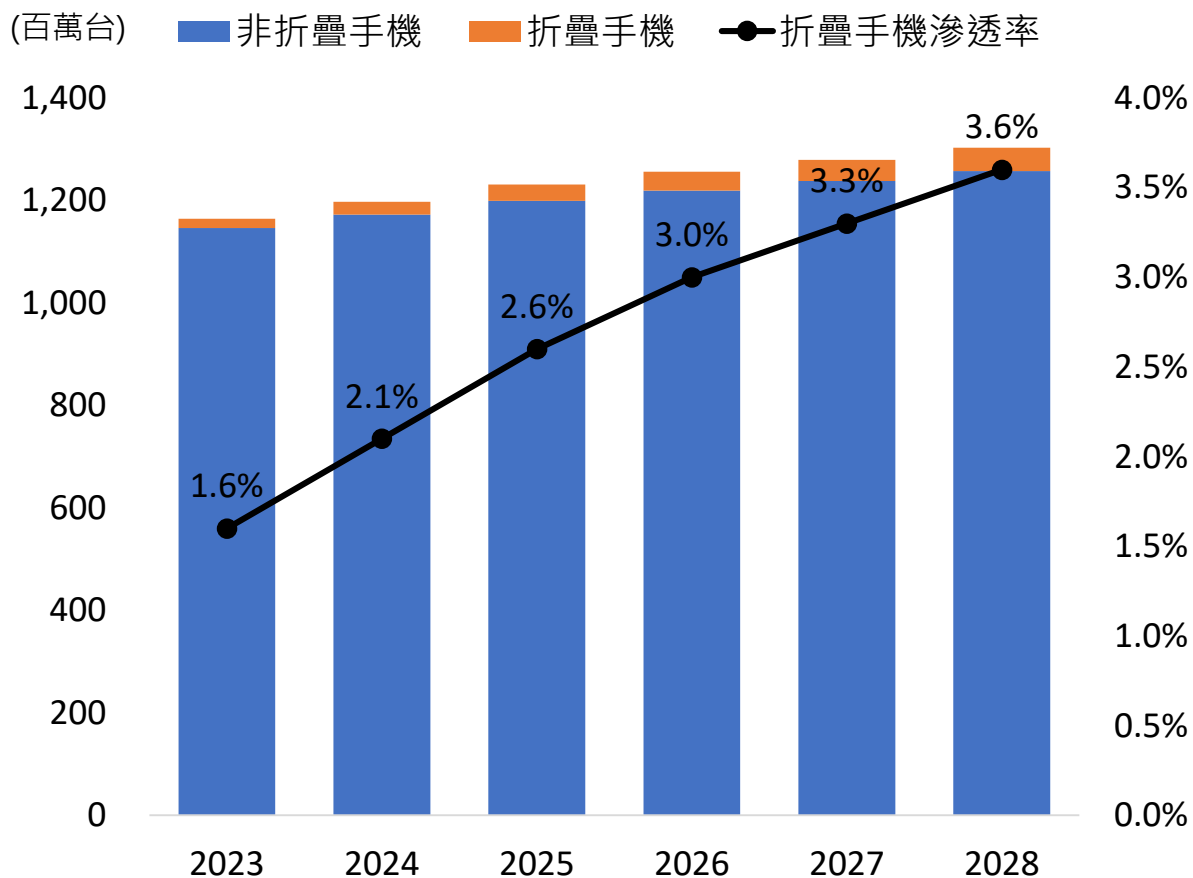
臻鼎2Q24車載/伺服器/基地台營收年增40.2%



臻鼎2Q24 IC載板單季營收續創新高

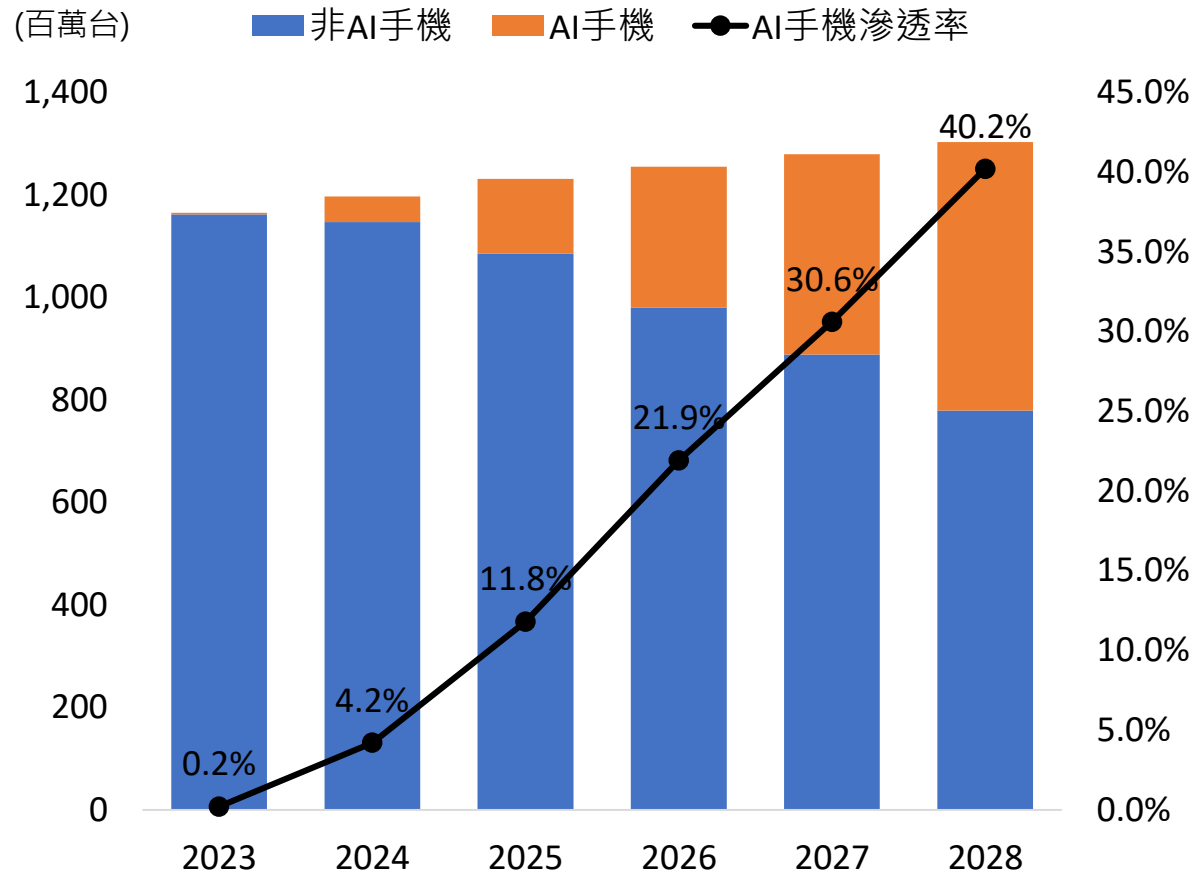


全球折疊手機市場規模：臻鼎已配合多家客戶出貨



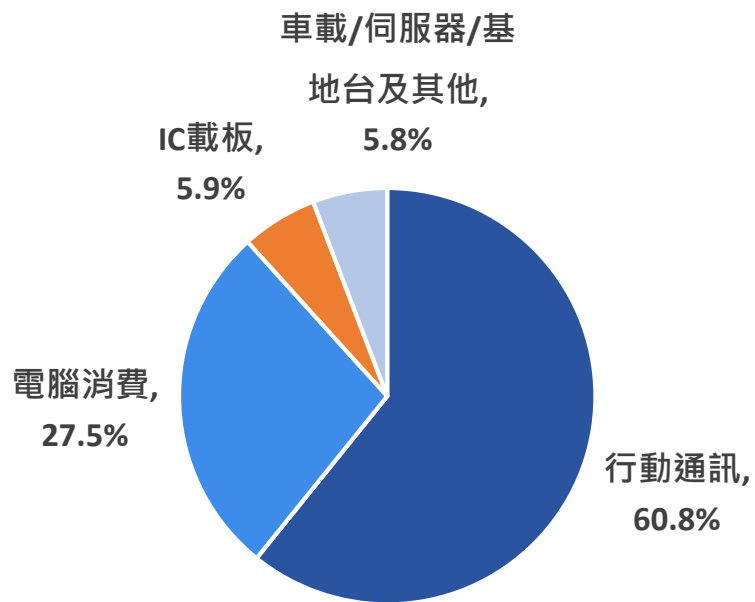
資料來源：IDC(2024/2)

全球AI手機市場規模：臻鼎積極與客戶開發新品

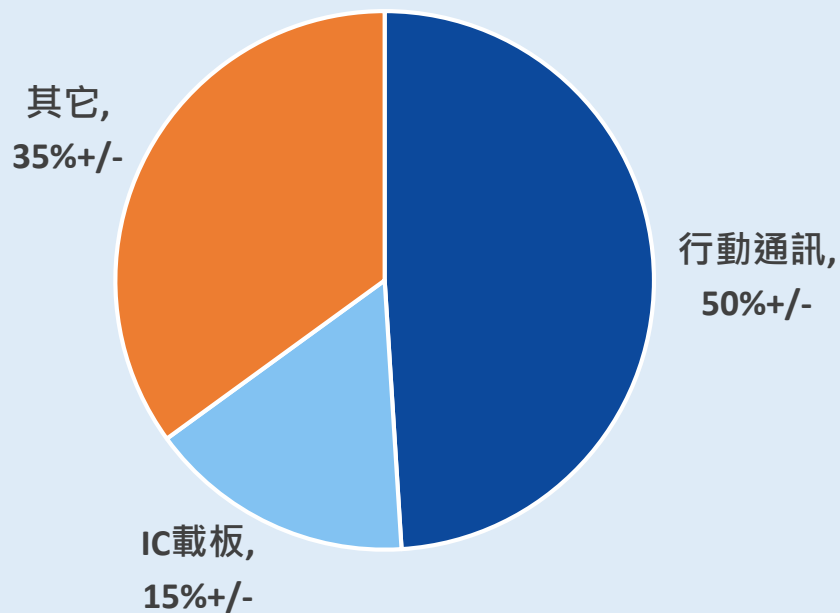


資料來源：IDC(2024/2)

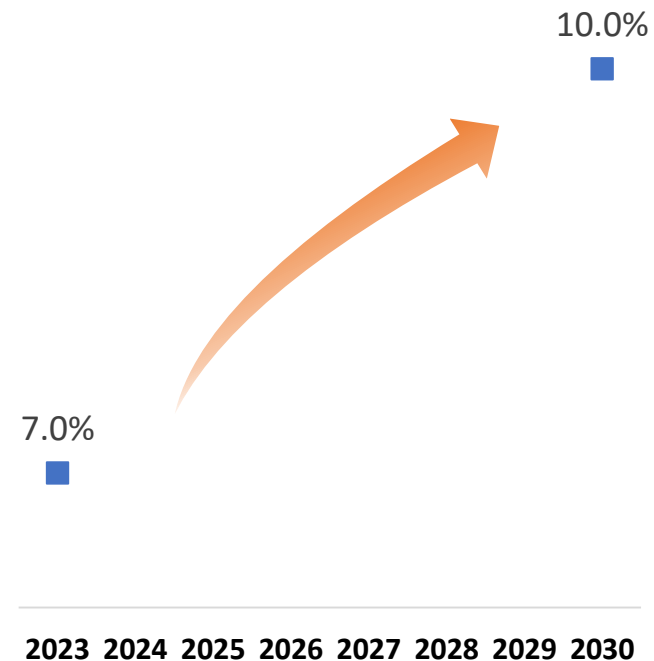
1H24營收新台幣649億



2027年目標營收產品應用比重



2030年目標全球市佔率達10%



積極拓展IC載板業務

目標2030年成為全球前五大

1

IC載板營收於1Q24再創單季新高，進入快速成長階段：

- IC載板業務1Q24營收佔比上升至5.7%，公司仍目標2023-2027營收複合成長率>50%，至2027年，IC載板預計貢獻合併營收15%+/-。

2

BT載板產能利用率續揚，已達單季獲利，且車載應用已進入量產：

- 臻鼎BT載板主要應用為手機處理器、記憶體、及射頻類，與一線客戶緊密合作，BT載板產能利用率於1Q24達逾80%，單季已獲利。
- ETS細線路6/8um預計將於年底邁入量產，2024年新開發之DDR-5與NAND載板也會逐季進入量產，公司產品皆達業界tier 1領先水準。

3

ABF載板陸續通過客戶認證及量產，大尺寸營收貢獻攀升，營收與產能利用率預期逐季走高：

- ABF載板方面，AI及車載需求佳，臻鼎積極布局這兩大領域相關客戶，並陸續通過客戶認證及量產，預期營收與產能利用率可望逐季走高。
- 已提供Chiplet高階載板供客戶認證。現出貨18~20層單顆最大尺寸92mm x 92mm產品，良率達ABF載板tier 1 供應商水準，已進入量產。單顆尺寸102mm x 102mm亦已出貨供客戶測試。

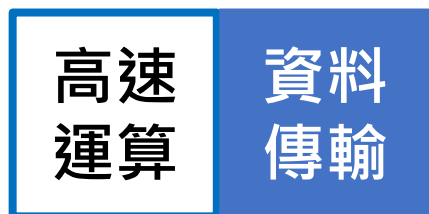
4

臻鼎對於來自國際客戶的「China for China」需求極具優勢：

- 為取得更多市場份額，國際客戶進入大陸市場逐漸需要佈建大陸本地產能，臻鼎擁有大陸最先進的IC載板廠，將可支應國際客戶「China for China」的需求，極具競爭優勢。

AI應用-Chiplet 小晶片載板

AI

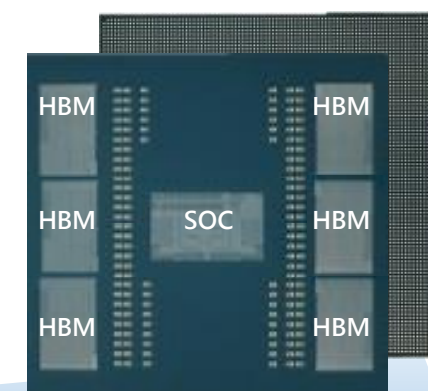


AI應用除需高速運算功能，
還需搭配快速讀寫記憶體空間

晶片解決方案



小晶片載板



載板需求技術

高層數	大尺寸	微孔	細線路	銅面處理技術
✓ 18~20層	✓ 90x90 ~ 95x95mm	✓ 40 ~ 60 um	✓ 9~15 um	✓ 低粗糙度，高結合力

**臻鼎
IC載板**

智能化



網域控制站

- 智駕網域控制站
- 座艙網域控制站

感測器

- 毫米波雷達
- 雷射雷達
- 攝像頭

使用晶片

自動駕駛AI晶片 影像感測器
智慧座艙晶片 存儲晶片
網域控制站DCU晶片 ADAS運算晶片

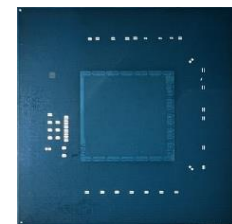


封裝方式

FCBGA
CSP

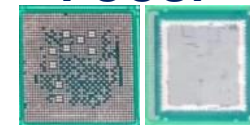
ZDT載板

FCBGA



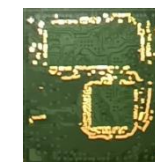
4~18L
17x17~75x75mm

FCCSP



2~4L
7x7~27x27mm

WBCSP



2~4L
7x7~27x27mm

互聯化



通信模組

- 遠端通訊盒

車聯網

- 5G 模組

智慧座艙晶片



CSP

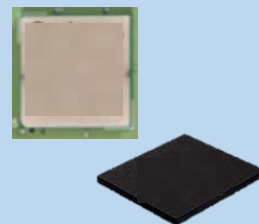
信息化



顯示系統

- HUD抬頭顯示
- AR/VR虛擬增強現實
- NFC近場通信

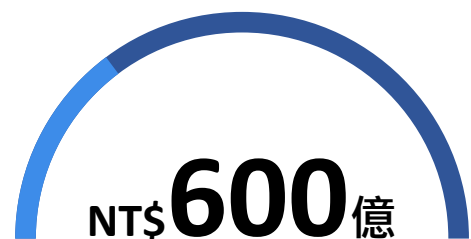
智慧座艙晶片
存儲晶片



FCBGA
CSP

IC載板產能規劃

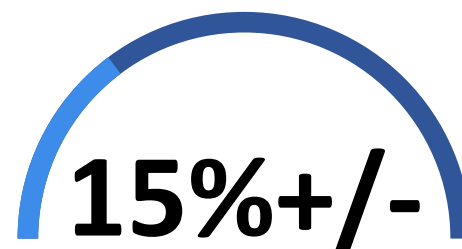
		2023				2024				2025				2026			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
深圳 ABF載板 (兩廠樓地板面積共17萬平方米)	Fab 1 (中高階產品)	裝機															
		樣品認證															
		量產，目標良率與tier 1競爭對手相當								產能滿載，目標良率與tier 1競爭對手相當							
Fab 2 (高階產品)										裝機							
														樣品認證			
														量產			
秦皇島 BT載板 (兩廠樓地板面積共6萬平方米)	Fab 1	技術與品質領先業界															
	Fab 2	量產				平均稼動率 80%+				技術與品質領先業界							



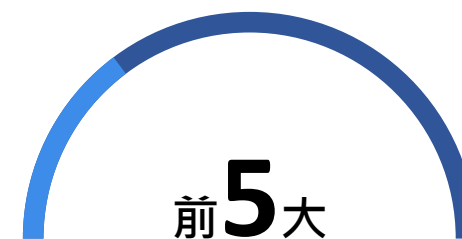
IC載板資本支出：
2022-2027規劃投資
600億



IC載板營收：
2023-2027複合
成長率 >50%



IC載板營收：
至2027年，IC載板占
臻鼎合併營收15%+/-



IC載板市占率：
目標2030年成為IC
載板全球前五大

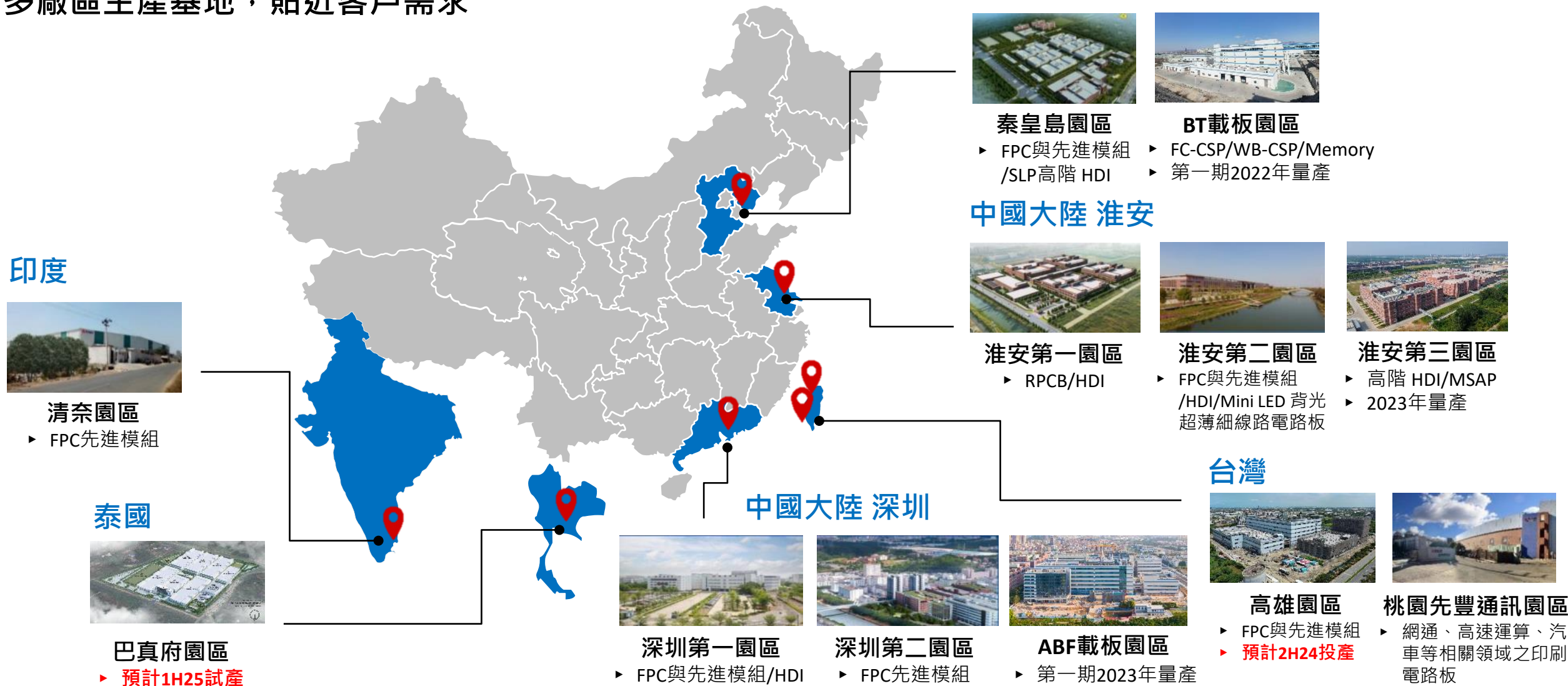


臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

全球化生產基地

多廠區生產基地，貼近客戶需求



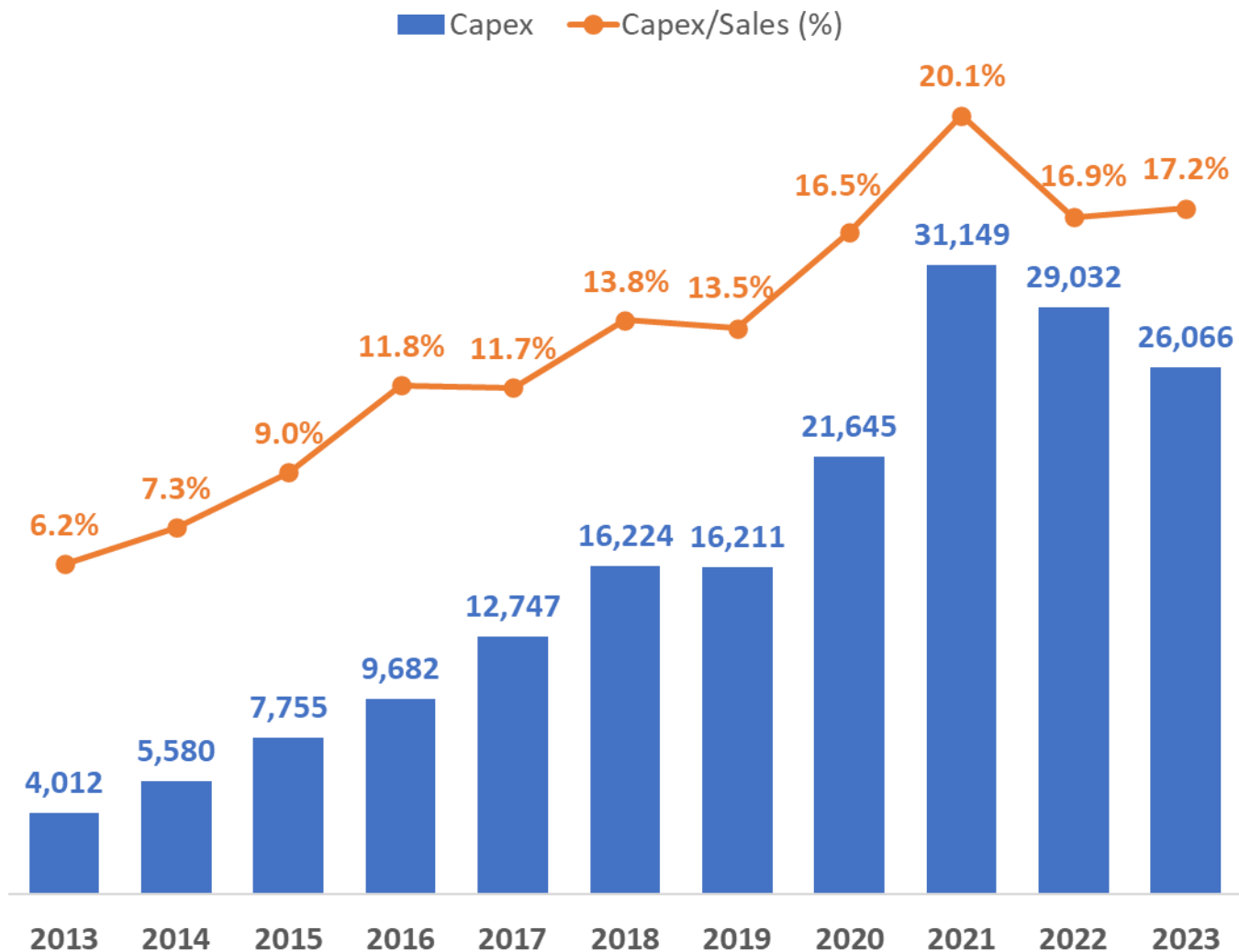
(去年12月)泰國巴真府園區第一期：高階 RPCB/HDI



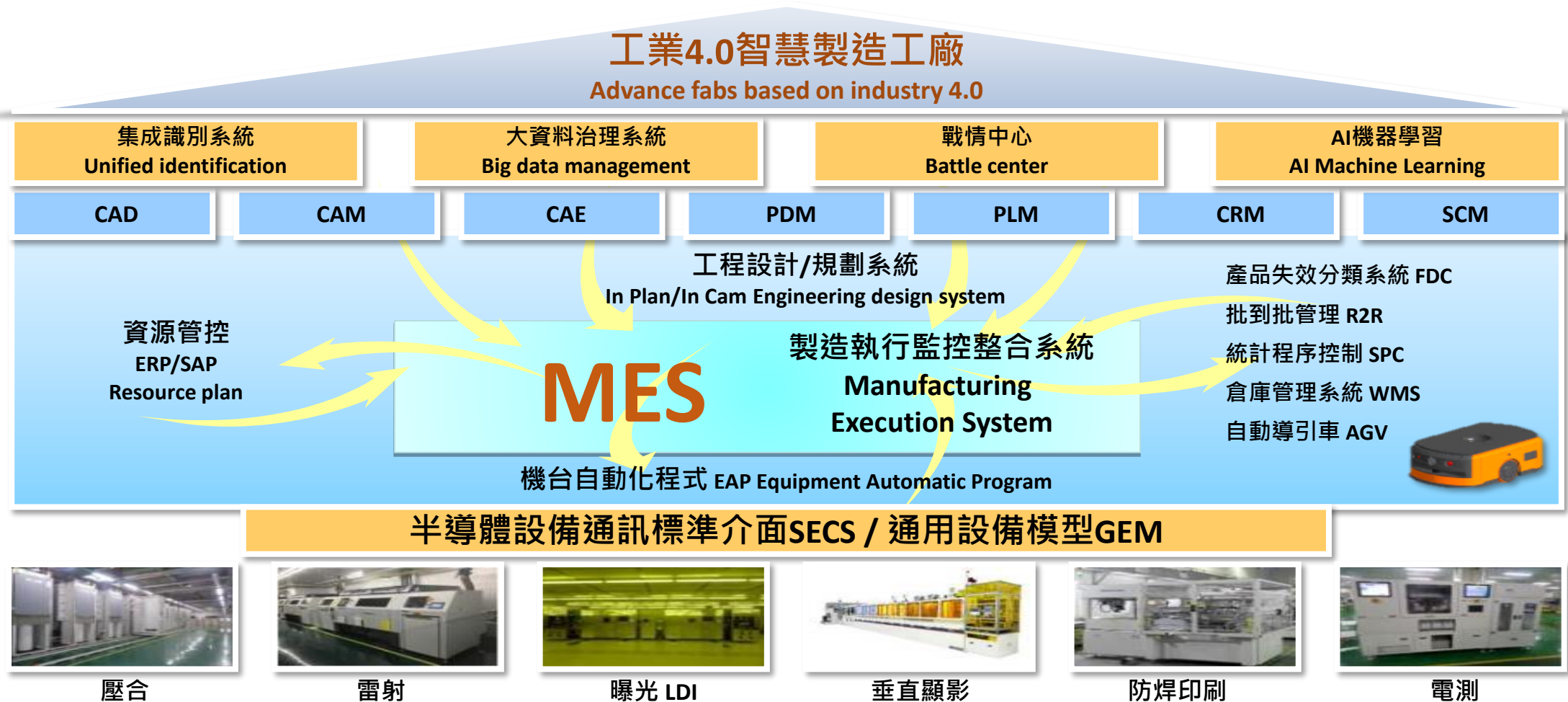
(現況)泰國巴真府園區第一期：高階 RPCB/HDI



- 泰國巴真府新廠第一期按計畫建設中，預計廠房8/26封頂，年底裝機，1H25試產、2H25小量產
- 第一期產能將以高階伺服器/車載/光通訊相關應用為主，提供高階RPCB/HDI產品
- 為臻鼎東南亞製造重要據點



- 身為全球第一大PCB製造商，臻鼎仍定位自身為成長型企業，持續以「糧草先行」策略，及早布局客戶所需產能。
- 今年將持續投入高雄廠與泰國廠的建置，為長期成長奠定基礎。



在One ZDT 策略下，各廠區分階段導入智能管理，目前淮安第三園區新廠已是導入智能管理的第九座工廠，在良率及效率上都有顯著的效益。

▶ 臺灣公司治理評鑑

2023年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度**入選臺灣證券交易所公司治理100指數**。

▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2023年S&P Global ESG 評級進步至73分，連續2年**入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)**，為唯一入選的PCB企業。

▶ Sustainalytics ESG 風險評級

2023年Sustainalytics ESG風險評級由17.8進步至15.6，為**低等風險等級**。

▶ ISS ESG 評級

最新年度的ISS ESG評級由「C」進步至「C+」，獲得「**優秀 (Prime)**」等級。

▶ CDP 碳揭露專案

2023年在氣候變遷獲得「B」等級，較去年進步一個等級。在水安全管理獲得「**A-**」**領導等級殊榮**，亦較去年進步一等級。

▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.3分（滿分為5分），成為**台灣上市櫃公司並列第四名**。



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

營運成果摘要

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

	2Q24	2Q23	年變化 (%)
營業收入	32,411	23,537	+37.7%
營業毛利	4,247	2,123	+100.1%
營業毛利率	13.1%	9.0%	+4.1ppts
營業費用	4,891	4,011	+21.9%
營業利益	(644)	(1,888)	
營業利益率	-2.0%	-8.0%	+6.0ppts
營業外收入及支出	1,153	1,393	-17.2%
本期淨利	667	150	+343.9%
淨利率	2.1%	0.6%	+1.5ppts
歸屬於母公司之淨利	486	(90)	
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	0.51	(0.09)	
研發費用	2,858	2,298	+24.4%
折舊及攤銷	4,346	4,042	+7.5%
營運活動之現金流入	1,899	3,471	-45.3%
現金及約當現金 ⁽²⁾	69,461	59,916	+15.9%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	2.0%	0.5%	+1.5ppts

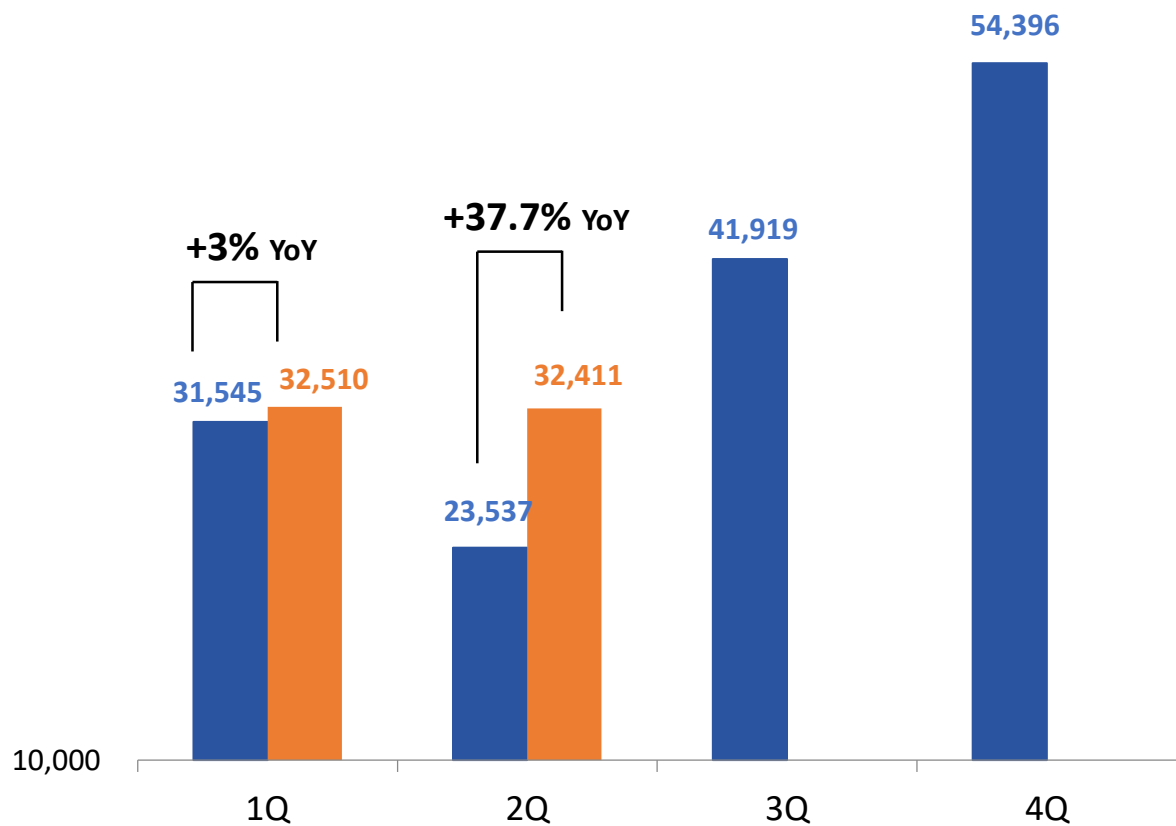
附註：(1) 2024年第一季加權平均流通在外股數為944,956仟股 (實際發行股本947,049仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2) 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

營業收入

■ 2023

■ 2024

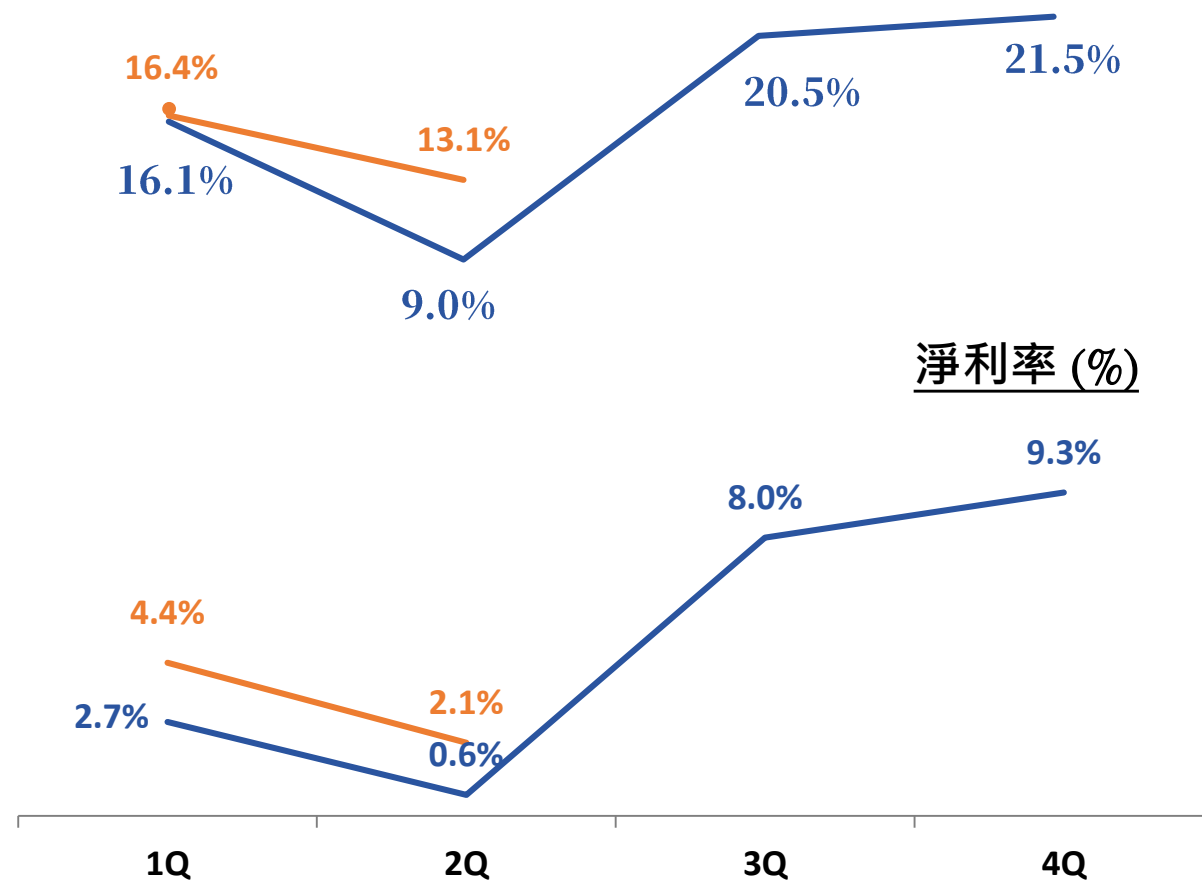
單位：新台幣佰萬元



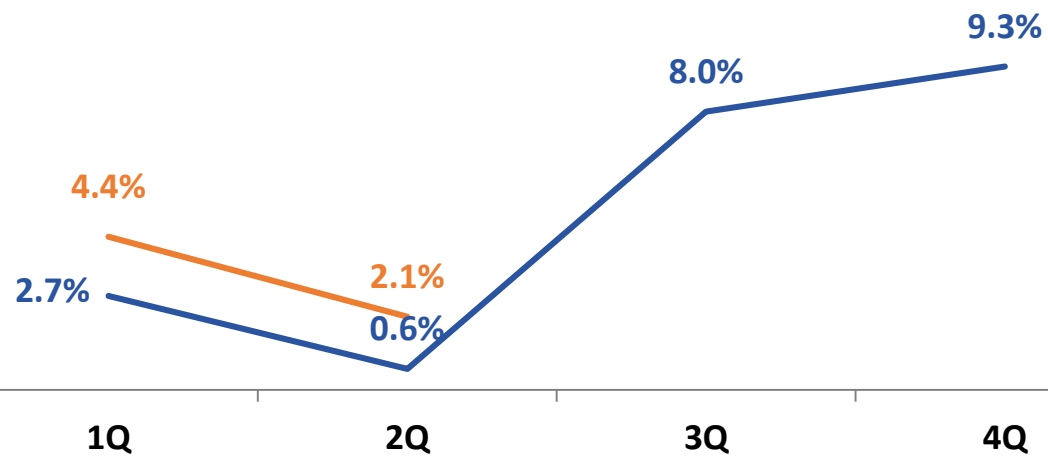
毛利率 (%)

— 2023

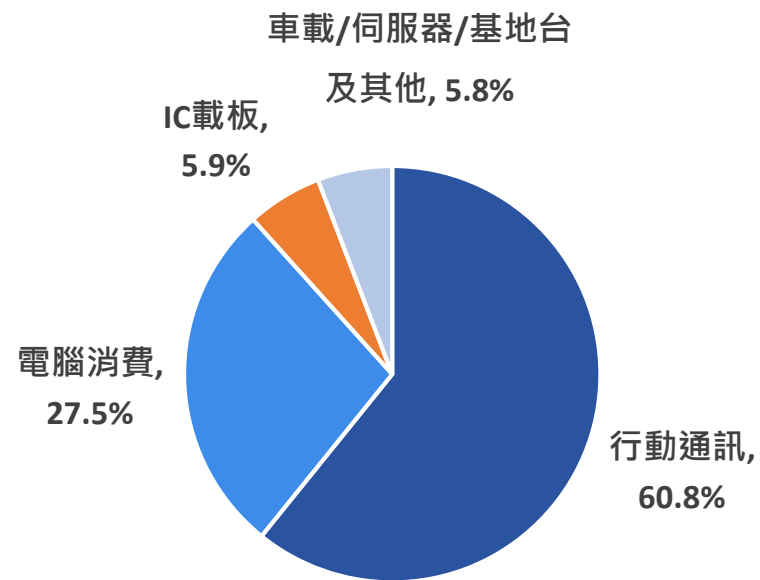
— 2024



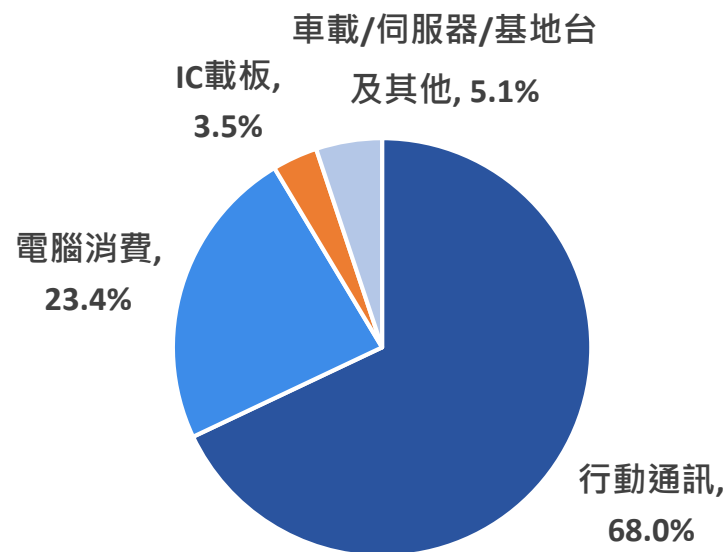
淨利率 (%)



1H24營收新台幣649億



1H23營收新台幣551億



產品別	1H24 營收YoY%
行動通訊	5.4%
電腦消費	38.6%
IC載板	96.7%
車載/伺服器/基地台及其他	33.3%

資產負債表及重要財務比率

	2024-6-30		2023-6-30		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	69,461	28.2%	59,916	26.8%	9,545	+1.4ppts
應收款項	22,317	9.1%	17,496	7.5%	4,821	+1.6ppts
存貨	18,784	7.6%	13,784	5.9%	5,000	+1.7ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	112,558	45.7%	108,559	48.5%	3,999	-2.8ppts
資產總額	246,563	100.0%	223,833	100.0%	22,730	
借款	54,590	22.1%	47,455	21.2%	7,135	+0.9ppts
應付款項	37,251	15.1%	35,325	15.8%	1,926	-0.7ppts
負債總額	107,321	43.5%	98,219	43.9%	9,102	
股東權益總額	139,242	56.5%	125,615	56.1%	13,627	

重要財務比率

平均收現日數(天)	72	78
平均銷貨日數(天)	61	66
流動比率(倍)	1.76	1.30
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.17	1.03

附註：(1) 2024年上半年加權平均流通在外股數為944,956仟股 (實際發行股本947,049仟股-庫藏股2,093仟股)。(2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

單位：新台幣佰萬元

年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
營業收入	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398
營業毛利	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459
本期淨利	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432
母公司淨利	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189
折舊及攤銷	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323
每股盈餘 (元)	9.12	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.550
每股股利 (元)	3.67	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275
分派比率 (%)	40.2%	45.9%	51.3%	51.3%	42.5%	45.3%	50.6%	49.0%	40.0%	50.0%
現金及約當現金 *	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970
不動產、廠房及設備	30,073	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965
資本額	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470
股東權益報酬率 (%)	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%
負債比率 (%)	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

Q&A



THANK YOU